

开源证券股份有限公司
关于深圳和美精艺半导体科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
上市保荐书

保荐机构（主承销商）



（陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层）

声 明

保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

（本上市保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《深圳和美精艺半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义）

目 录

声 明.....	1
目 录.....	2
第一节 发行人基本情况	3
一、发行人概况	3
二、发行人主营业务、核心技术和研发水平	3
三、发行人报告期的主要经营和财务数据及指标	9
四、发行人存在的主要问题和风险	9
第二节 本次证券发行基本情况	18
一、本次发行概况	18
二、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员介绍	18
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况	19
四、保荐机构内部审核程序和内核意见	20
第三节 保荐机构承诺事项	22
第四节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见	23
一、发行人关于本次证券发行的决策程序	23
二、发行人符合《证券法》规定的发行条件	23
三、发行人符合科创板定位的说明及保荐机构的核查情况	24
四、发行人符合《上市规则》规定的上市条件	27
五、保荐机构推荐结论	29
第五节 发行人证券上市后持续督导工作的具体安排	31

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

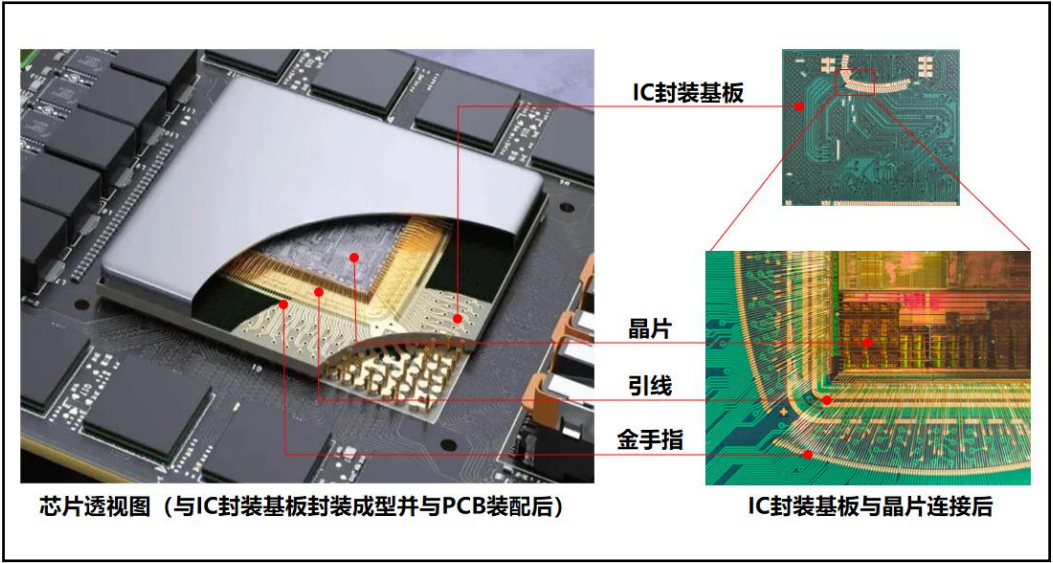
发行人	深圳和美精艺半导体科技股份有限公司
英文名称	Shenzhen Hemei Jingyi Semiconductor Technology Co., Ltd.
注册资本	17,746.50万元
法定代表人	岳长来
有限公司成立日期	2007年6月28日
整体变更为股份公司日期	2020年12月7日
住所	深圳市龙岗区坪地街道四方埔社区牛眠岭新村26号二楼
邮政编码	518117
电话	0755-89944891
传真	0755-89947648
互联网网址	http://www.hmjy-ic.com
电子邮箱	HMJY@hmjy-ic.com
负责信息披露和投资者关系的部门	证券部
信息披露和投资者关系负责人	刘绍林
信息披露和投资者关系负责人电话	0755-89942850

二、发行人主营业务、核心技术和研发水平

（一）发行人主营业务

发行人自 2007 年成立至今，一直专注于 IC 封装基板领域，从事 IC 封装基板的研发、生产和销售，以“提供有竞争力的 IC 封装基板解决方案和服务，持续为客户创造最大的价值”为使命，以“成为全球最佳 IC 封装基板供应商”为愿景。

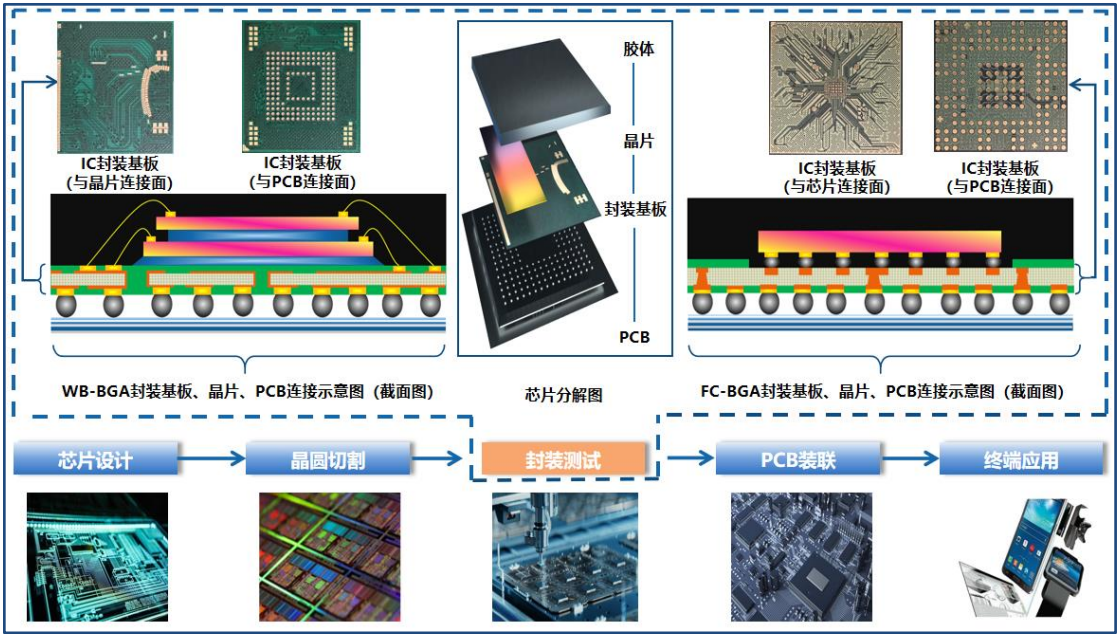
IC 封装基板是芯片封装环节的核心材料，具有高密度、高精度、高性能、小型化及薄型化等特点，与晶片、引线等经过封装测试后共同组成芯片。IC 封装基板不仅为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时为芯片与 PCB 之间提供电子连接，起着“承上启下”的作用，甚至可埋入无源、有源器件以实现一定系统功能，其连接示意图如下所示：



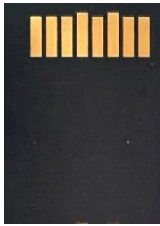
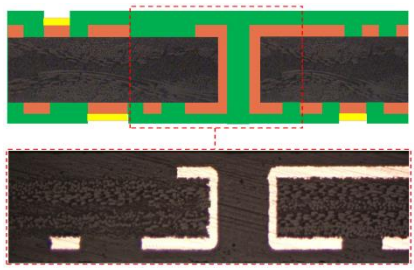
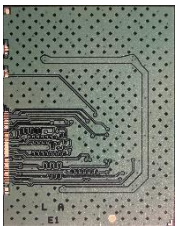
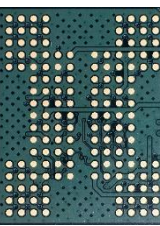
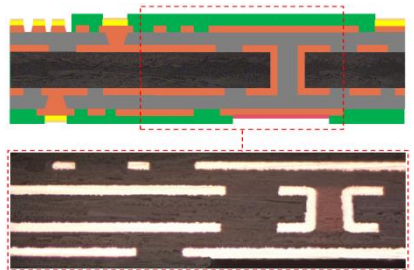
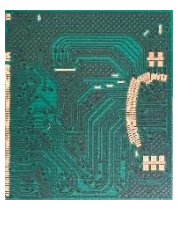
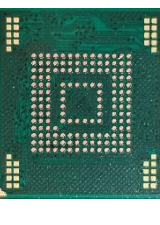
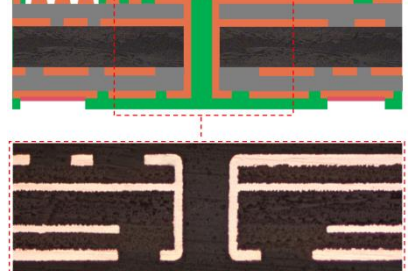
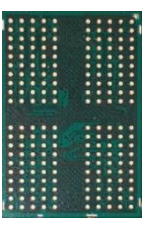
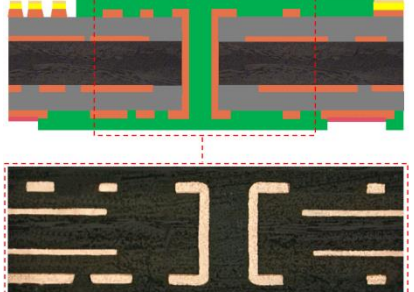
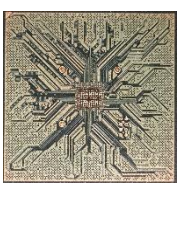
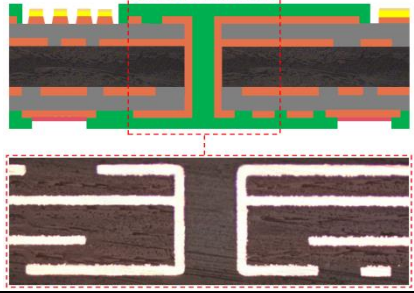
（二）发行人主要产品或服务的核心技术情况

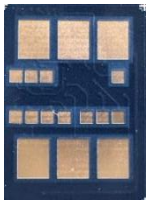
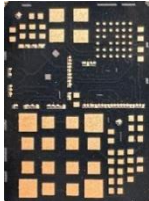
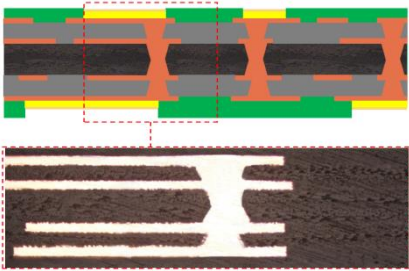
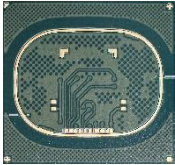
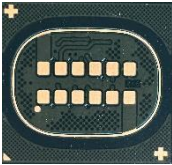
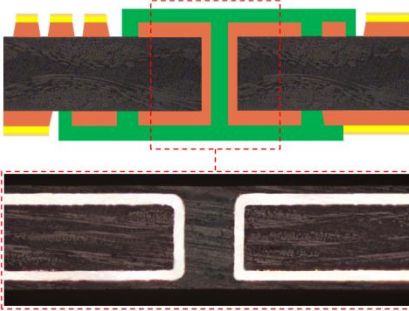
1、发行人主要产品

发行人主要产品为存储芯片封装基板，产品类型有：移动存储芯片封装基板、固态存储芯片封装基板、嵌入式存储芯片封装基板以及易失性存储芯片封装基板。此外，发行人也生产少部分非存储芯片封装基板，产品类型有：逻辑芯片封装基板、通信芯片封装基板和传感器芯片封装基板等。发行人主要产品结构图如下所示：

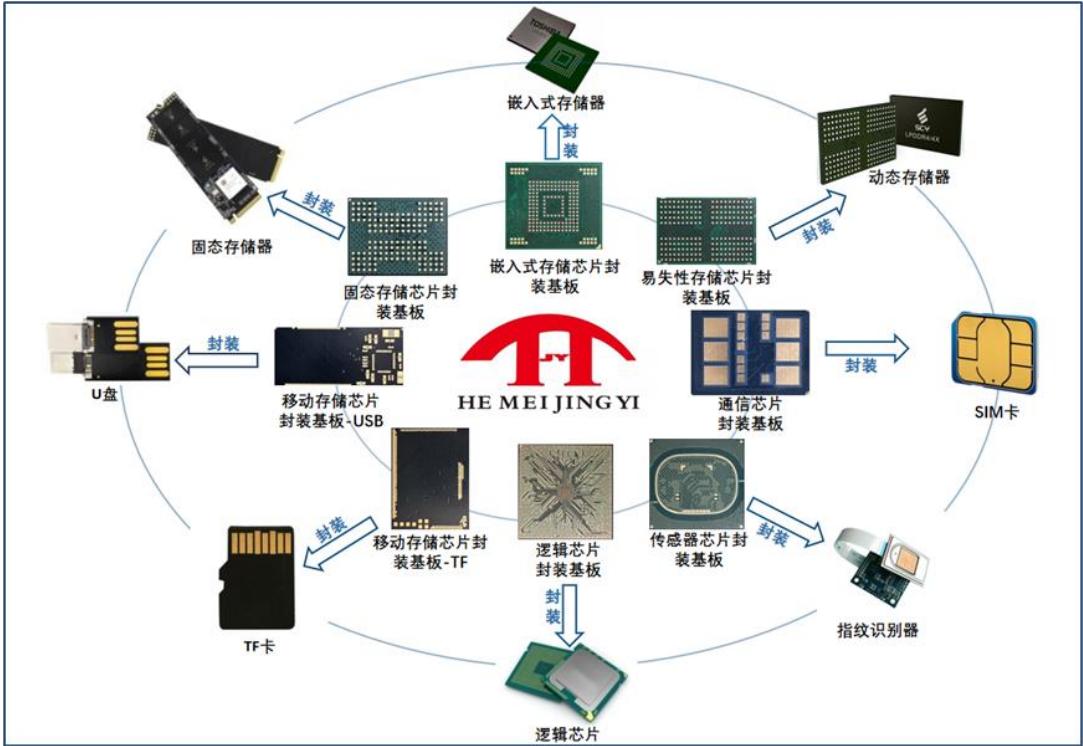


发行人产品具体情况如下所示：

产品大类	产品类型	与晶片连接面	与PCB连接面	产品截面示意图及切片放大图	封装工艺/基板材料
存储芯片封装基板	移动存储芯片封装基板				WB-CSP BT材料
	固态存储芯片封装基板				WB-BGA BT材料
	嵌入式存储芯片封装基板				WB-BGA BT材料
	易失性存储芯片封装基板				WB-BGA BT材料
非存储芯片封装基板	逻辑芯片封装基板				FC-BGA/LGA/ PBGA BT、国产高性能PP材料

产品大类	产品类型	与晶片连接面	与PCB连接面	产品截面示意图及切片放大图	封装工艺/基板材料
	通信芯片封装基板				WB-BGA BT材料
	传感器芯片封装基板				WB-CSP BT材料

发行人产品广泛应用于智能手机、平板电脑、PC、智能穿戴设备、数据服务器、汽车电子等终端领域。IC封装基板经过封装以后的最终应用终端如下所示：



2、发行人技术先进性及表征

发行人系大陆内资厂商中少数几家全面掌握自主可控 IC 封装基板大规模量产技术的企业，发行人在自主可控 IC 封装基板研发与产业化领域已有超过十五

年的持续积累与沉淀，具备较强的 IC 封装基板研发与制造能力。截至本上市保荐书签署日，发行人已取得 16 项发明专利，发明专利均与发行人的核心技术相对应。

发行人的核心技术均来源于自主研发，具体情况如下：

序号	核心技术名称	核心子技术	应用情况	对应发明专利
1	超密线路图形制作技术	1、产品设计线路自动补偿技术 2、超密线路影像转移技术	大批量生产	1、一种三层板MSAP工艺制造方法及三层板 2、一种封装基板的加工生产设备及加工方法
2	精密压合及成型技术	1、超薄PP材料压合技术 2、高精度多层板层间对位技术	大批量生产	1、一种三层板结构的封装基板制作方法 2、一种BOC产品捞内槽加工方法及封装基板 3、IC基板、制备方法及应用其的电子封装件
3	精准防焊技术	1、高平整度油墨真空整平技术 2、干膜型油墨防焊技术	大批量生产	1、一种封装基板油墨前塞涂布塞孔的方法 2、一种封装基板的防焊装置及防焊方法 3、一种封装基板的阻焊激光开窗去油墨方法
4	高精度电镀技术	1、高密度盲埋孔电镀填充技术 2、高均匀性镀铜技术 3、高均匀性镀镍金技术	大批量生产	1、一种四层NanoSIM卡类的封装基板及其制作方法 2、一种多层板盲孔埋孔填充封装基板制作方法 3、一种在印刷电路板的导电层中设置金属钯层的方法及其层状结构 4、一种无电镀导线镀金工艺方法 5、一种双面OSP工艺的封装基板加工方法
5	智能化检测及标记技术	1、AVI检测机与自动找点机联网检测技术 2、自动识别分叉技术 3、全制程无笔刀不良品标记技术	大批量生产	1、一种AVI检测机与自动找点机联网检测封装基板的方法 2、一种封装基板包装前自动分叉机装置及分叉方法 3、IC封装基板的测试方法及系统

（三）发行人科研实力和技术成果情况

1、发行人的专利

截至本上市保荐书签署日，发行人及其子公司共拥有有效专利 99 项，其中

发明专利 16 项，实用新型专利 83 项。

2、发行人取得的重要荣誉

截至本上市保荐书签署日，发行人获得的重要荣誉如下：

序号	荣誉名称	颁发机构	颁发时间
1	“5G高频高密度线路板”高新技术产品证书	广东省高新技术企业协会	2019.12
2	“超薄多层封装线路板”高新技术产品证书	广东省高新技术企业协会	2019.12
3	“IC封装基板”高新技术产品证书	广东省高新技术企业协会	2019.12
4	2019年度中国电子电路行业百强企业	中国电子电路行业协会、中国电子信息行业联合会	2020.08
5	国家高新技术企业	深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局	2020.12
6	“超薄高精多层印刷电路板”名优高新技术产品证书	广东省高新技术企业协会	2022.03
7	广东省电子信息行业同类细分领域前三名	广东省电子信息行业协会	2022.03
8	特色产品主要企业（内资）-封装基板	中国电子电路行业协会	2022.05
9	专精特新“小巨人”企业	国家工信部	2022.08
10	第五届中国电子电路行业优秀企业	中国电子电路行业协会	2022.11
11	科学技术成果登记证书-大容量嵌入式存储芯片封装基板关键技术及应用-处于国内领先水平	国家工业信息安全发展研究中心	2023.01
12	“存储芯片封装基板”名优高新技术产品证书	广东省高新技术企业协会	2023.01
13	大容量嵌入式存储芯片封装基板关键技术及应用-科技进步二等奖	广东省电子信息行业协会	2023.10

3、核心技术产业化情况

发行人的核心技术均应用于主营业务相关产品的生产。报告期内，发行人核心技术转化为收入的情况如下：

单位：万元

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
核心技术产品收入	16,063.75	30,996.26	25,073.26	18,822.43
营业收入	16,228.72	31,199.87	25,369.54	18,901.07
核心技术产品收入占比	98.98%	99.35%	98.83%	99.58%

（四）发行人研发投入情况

报告期内，发行人研发投入及占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	16,228.72	31,199.87	25,369.54	18,901.07
研发投入	1,186.19	2,536.37	2,291.16	1,312.17
研发投入占营业收入的比例	7.31%	8.13%	9.03%	6.94%

三、发行人报告期的主要经营和财务数据及指标

项目	2023年1-6月 /2023.6.30	2022年度 /2022.12.31	2021年度 /2021.12.31	2020年度 /2020.12.31
资产总额（万元）	101,228.04	97,130.42	86,981.21	36,141.60
归属于母公司所有者权益（万元）	82,475.30	80,932.23	72,474.45	28,869.75
资产负债率（母公司）	10.88%	7.10%	13.96%	25.96%
营业收入（万元）	16,228.72	31,199.87	25,369.54	18,901.07
净利润（万元）	1,520.97	2,932.36	1,924.70	3,687.13
归属于母公司所有者的净利润（万元）	1,520.97	2,932.36	1,924.70	3,687.13
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	1,194.37	2,077.04	1,843.16	3,364.32
基本每股收益（元/股）	0.09	0.17	0.15	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.17	0.15	0.31
加权平均净资产收益率	1.86%	3.85%	6.45%	17.27%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	697.58	4,257.12	-2,011.61	3,890.80
现金分红（万元）	-	-	-	-
研发投入占营业收入的比例	7.31%	8.13%	9.03%	6.94%

四、发行人存在的主要问题和风险

（一）与发行人相关的风险

1、技术风险

（1）技术革新的风险

发行人主营业务为 IC 封装基板的研发、生产与销售，该行业属于技术密集

型产业，企业须持续开展研发投入及工艺改进，以提升核心竞争力，助力企业稳健发展。

在境外市场，欣兴电子、南亚电路、揖斐电、三星电机等企业在 IC 封装基板领域深耕多年，具备丰富的技术积累；而在境内市场，深南电路、兴森科技等企业亦凭借其产品和资金等优势，纷纷布局 IC 封装基板领域。因此，发行人只有坚持创新、不断提升自身技术水平，才能在中高端 IC 封装基板市场占据一席之地。但考虑到未来市场变化、技术变革及发行人自身研发过程存在的各种不可预见因素等，若发行人未来无法保持在产品和技术工艺等方面的持续突破，发行人将面临产品研发与工艺技术落后的风险。

（2）研发未取得预期效果的风险

IC 封装基板行业属于技术密集型产业，为巩固和提升市场竞争地位，发行人持续保持较高的研发投入。报告期内，发行人各期研发投入分别为 1,312.17 万元、2,291.16 万元、2,536.37 万元和 1,186.19 万元，占营业收入的比例分别为 6.94%、9.03%、8.13%和 7.31%。而相关技术成果需要在市场转化过程中接受严格的检验，如果发行人在研发过程中未能实现关键技术的突破，或相关技术无法实现产品化、商业化，则发行人可能面临研发投入未取得预期效果的风险。

（3）技术泄密和核心技术人员流失的风险

经过多年的自主研发和技术创新，发行人积累了多项专利与核心技术，并培养了一批经验丰富的技术人员。为保护发行人的核心技术，发行人采取了严格的保密措施，与核心技术人员签署了保密协议、竞业限制协议等，并通过申请专利、集成电路布图设计等方式进行有效保护。

但随着国内众多企业纷纷布局 IC 封装基板领域，该行业对技术人才的争夺日益加剧。若发行人未来不能在薪酬、福利、人才培养等方面持续提供具有竞争力的待遇或激励措施，加之技术秘密保护措施存在局限性等因素，发行人可能面临核心技术人员流失、核心技术失密的风险。

2、经营风险

（1）客户集中度较高的风险

发行人的客户主要集中在华南地区，报告期内，华南地区客户产生的收入占比分别为 78.61%、62.01%、67.37%及 69.55%。如果相关客户的经营状况或市场竞争环境在未来发生重大不利变化，同时发行人无法有效拓展其他地区客户，发行人可能面临业绩下滑的风险。

此外，报告期内，发行人前五大客户产生的收入占主营业务收入的比例分别为 56.73%、53.53%、47.30%及 48.02%，若发行人未来与主要客户的合作发生变化，或主要客户的经营状况发生变化，从而降低对发行人产品的采购需求，将会对发行人的经营业绩造成不利影响。

（2）主要原材料价格波动风险

IC 封装基板的主要原材料为金盐 and 覆铜板，其占发行人主营业务成本的比例较高。报告期内，原材料占主营业务成本的比例分别为 61.25%、52.53%、51.46%及 47.95%。

金盐、覆铜板的价格受国际市场黄金、铜等大宗商品价格的影响较大，其价格波动对发行人的成本结构具有较大影响。未来若原材料价格出现大幅波动，而发行人不能通过价格传导或技术创新等措施有效化解原材料价格上涨的压力，抑或在原材料价格下跌趋势中未能做好存货管理，发行人的经营业绩将受到不利影响。

（3）正基电子使用土地、厂房存在行政处罚、搬迁的风险

2006 年 6 月 30 日，正基电子与四方埔公司签署《合作协议书》，约定四方埔公司将金牛工业区的一块土地与正基电子合作办厂。截至本上市保荐书签署日，正基电子自建厂房尚未取得房屋权属证书。此外，根据深圳市规划和自然资源局发布的《深圳市 2020 年度城市更新和土地整备计划》，正基电子自建厂房所在地被划入“坪地四方埔社区土地整备利益统筹项目”，存在被拆除的风险。

虽然深圳市龙岗区规划土地监察局出具的《复函》载明“上述土地及建筑的建设和使用不属于重大违法、违规行为，我局无需对此进行立案处罚”、深圳市

龙岗区城市更新和土地整备局亦出具《复函》载明“可通过优化分期，避免纳入首期拆除范围，从而确保 5 年内不予拆除”，但如果未来政策突然发生变化，则正基电子仍可能面临被行政处罚及搬迁的风险。

3、财务风险

（1）固定资产折旧增加的风险

报告期各期末，发行人在建工程账面价值分别为 2,908.48 万元、4,956.14 万元、18,539.35 万元和 17,438.01 万元，占当期非流动资产的比例分别为 22.09%、18.36%、41.25%和 34.10%，若发行人未来经营无法有效实现固定资产投入的预期新增效益，则在建工程结转固定资产导致的折旧增加将对发行人经营业绩产生不利影响。

（2）毛利率波动的风险

报告期各期，发行人的主营业务毛利率分别为 35.12%、24.34%、20.37%和 20.78%，存在一定幅度的波动。发行人的主营业务毛利率主要受市场供求关系、供应商及客户的议价能力、固定资产折旧等因素影响。

如果未来半导体行业整体情况发生重大不利变化、下游客户对 IC 封装基板的需求减弱、主要原材料价格大幅上涨、产能扩张导致折旧费用大幅增加，以及发生其他重大不利情况，可能导致发行人在未来一定时期内面临毛利率波动的风险。

（3）应收账款出现坏账损失的风险

报告期各期末，发行人应收账款账面价值分别为 6,250.01 万元、9,649.14 万元、12,009.77 万元和 16,151.89 万元，占当期流动资产的比例分别为 27.20%、16.08%、23.01%和 32.25%；发行人应收账款账面价值占当期营业收入的比例分别为 33.07%、38.03%、38.49%和 49.76%（经年化计算）。

随着发行人营业收入的快速增长，应收款项金额可能持续增加。若发行人主要客户出现违约等情形，将发生应收账款未能及时收回或无法收回的风险，进而对发行人的现金流和财务状况产生不利影响。

(4) 政府补助及税收优惠政策变动的风险

报告期各期，发行人计入当期损益的政府补助金额分别为 323.74 万元、266.46 万元、534.22 万元和 222.93 万元，如果发行人未来不能持续获得政府补助或政府补助显著降低，将会对发行人业绩产生不利影响。

发行人于 2020 年 12 月 11 日被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》（证书编号 GR202044202581），有效期 3 年。正基电子于 2020 年 12 月 11 日取得《高新技术企业证书》（证书编号 GR202044206482），有效期 3 年。江门和美于 2022 年 12 月 19 日取得《高新技术企业证书》（证书编号 GR202244001480），有效期 3 年。报告期内，发行人享受的高新技术企业税收优惠总额分别为 321.19 万元、154.40 万元、193.89 万元和 87.08 万元。如果国家对高新技术企业税收优惠政策发生变化，或者发行人与子公司无法通过高新技术企业复审或不再符合相关认定标准，发行人将不能再适用 15% 的所得税优惠税率，且需要补缴按优惠税率缴税期间少缴的税款，这将导致发行人所得税税负上升，发行人的盈利水平将受到一定程度的影响。

(5) 汇率波动的风险

报告期内，发行人外销收入占当期主营业务收入的比例分别为 6.08%、25.46%、13.76% 和 13.00%，主要使用美元等外币进行结算。报告期内，受到宏观经济、地缘政治等多重因素影响，人民币兑外币的汇率波动显著，发行人的汇兑损益分别为 10.55 万元、-59.41 万元、-253.28 万元和 19.83 万元，占各期利润总额的比例较低。在人民币汇率波动的情况下，发行人以外币结算的出口销售可能会造成汇兑损失，从而对发行人的经营业绩和财务状况产生不利影响。

4、内部控制风险

(1) 规模扩张引发的管理风险

发行人已经按照有关法律法规和制度的要求，建立健全了各项内部控制制度，形成了相对完善的内部控制体系。内控制度的有效运行，保证了发行人经营管理活动的正常有序开展，并有效控制了风险。但随着发行人业务规模的持续扩大，经营管理、财务监控、资金调配等工作日益复杂，将对发行人的内部控制提出更高要求。如果发行人的内部控制体系不能随发行人业务的发展不断完善并得到有

效执行，则可能对发行人的经营产生不利影响。

（2）控制权不稳定的风险

发行人控股股东、实际控制人岳长来直接持有发行人 4,896.76 万股股份，占发行人总股本的 27.59%。岳长来、朱圣峰（持股比例为 5.39%）、居永明（持股比例为 4.04%）、何福权（持股比例为 2.96%）签署一致行动协议，约定“自协议签署之日起至发行人股票上市之日起 36 个月内，朱圣峰、居永明、何福权作为发行人股东、董事行使权利时，应始终与岳长来保持一致的意思表示”。根据该协议，岳长来合计控制发行人发行前 39.98%的表决权份额。本次发行完成后，岳长来实际支配的发行人股份比例将被稀释。在目前的股权架构条件下，不排除上市后主要股东持股比例变动而对发行人的人员管理、业务发展和经营业绩产生不利影响的可能性。此外，实际控制人持股比例降低导致的控制权不稳定风险，如届时缺乏妥善的处理措施，可能对发行人的长期稳定发展造成不利影响。

5、法律风险

（1）部分生产经营场所为租赁取得的风险

江门和美、江苏和美、和美深圳分公司的生产经营场所为采取租赁方式取得，未来如果发生租赁协议到期无法续租的情形，前述分、子公司需要更换办公场地，可能会对发行人的正常经营造成不利影响；如果发生租金大幅上涨的情形，可能会对发行人整体的经营业绩造成不利影响。

（2）安全生产与环保的风险

发行人主要产品生产过程中会产生少量废气、废水、废渣，如果处理不当，可能会对周围环境产生不利影响。随着监管政策的趋严、发行人业务规模的扩张，安全生产与环保压力同步增大，可能会存在因设备故障、人为操作不当、自然灾害等不可抗力事件导致的安全生产和环保事故风险。

一旦发生安全生产或环保事故，发行人不仅会面临直接损失，还会面临被有关监管部门处罚、责令整改或停产的风险，进而影响发行人正常生产经营。

6、募投项目实施风险

(1) 募集资金投资项目实施风险

发行人本次募集资金主要用于珠海富山 IC 载板生产基地建设项目(一期),该募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对技术发展趋势的判断等因素作出的。在发行人募集资金投资项目实施过程中,发行人可能面临市场变化、发行人组织管理和市场营销的执行情况未及预期、遭遇突发性事件等不确定风险,导致项目未能按计划正常实施,进而影响项目投资收益和发行人经营业绩。

(2) 募投项目实施后产能消化的风险

本次募集资金投资项目珠海富山 IC 载板生产基地建设项目(一期)系新增产能项目,如未来市场环境发生较大不利变化、下游客户需求增速低于预期,且发行人不能及时有效地开拓市场,消化新增的产能,则发行人或将无法按照既定计划实现预期的经济效益,从而对发行人业务发展产生不利影响。

(3) 募集资金投资项目实施后发行人折旧摊销增加的风险

发行人本次拟使用募集资金 60,000.00 万元用于珠海富山 IC 载板生产基地建设项目(一期),20,000.00 万元用于补充流动资金。本次募集资金投资项目实施后,发行人的固定资产和无形资产规模将有较大幅度的增长,折旧摊销费用也将相应增加。如果市场环境发生重大变化,募集资金投资项目的实际收益不能消化新增的折旧和摊销费用,则发行人或将面临利润下滑的风险,进而对发行人未来业绩和财务状况产生重大不利影响。

(二) 与行业相关的风险

1、行业政策变动风险

半导体产业是信息技术产业的基础和重要组成部分,国家对高质量发展半导体行业高度重视,相继出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等支持性政策。相关政策对支持行业内企业自主创新、做大做强发挥了重要作用,为行业内企业创造了良好的发展机遇。若

未来国家对相关政策予以调整，对集成电路封装和测试行业或上下游行业的支持力度有所减弱，则或将对发行人的长足发展产生不利影响。

2、行业竞争加剧风险

在 IC 封装基板行业内，中国内资生产商较少，目前，行业主要市场份额仍被中国台湾、日本、韩国的厂商占据。预计在未来较长时期内，该行业仍将维持较为激烈的竞争格局。同时，随着下游应用领域竞争的加剧、产品价格的走低，IC 封装基板行业亦存在价格下降的风险。

根据中国台湾电路板协会统计，2022 年全球封装基板产值约为 178.4 亿美元，以厂商资金类别（含其在中国大陆等非其本土投资控股的工厂，以下相关统计均参照此口径¹）为基准，中国台湾为最大封装基板供应者，约占整体产值的 38.3%，其次为韩国与日本，三地厂商累计占据 90% 以上的全球封装基板市场；中国内资厂商仅占整体产值约为 3.2%。与行业龙头企业相比，发行人在经营规模、市场占有率等方面均存在一定差距。随着国内 IC 封装基板企业的纷纷扩产，未来市场竞争或将进一步加剧，若发行人在生产管理、技术水平及产品质量等方面未能持续精进，则其经营业绩或将遭受不利影响。

3、国际贸易摩擦风险

发行人的部分产品存在对外出口情况，且部分国内客户的终端产品亦存在对外出口的可能性。报告期内，发行人出口业务收入分别为 1,143.58 万元、6,383.61 万元、4,265.97 万元和 2,088.49 万元，占主营业务收入的比例分别为 6.08%、25.46%、13.76% 和 13.00%。随着国际局势的不断变化，不排除未来其他国家或地区对我国出口产品采取限制措施的可能。若国际贸易摩擦范围扩大或持续升级，抑或是其他进口国设置贸易壁垒，则可能阻碍发行人的海外销售，对发行人营业收入的增长带来不利影响。此外，发行人生产过程中所使用的油墨主要由日本太阳油墨株式会社供应，该公司是全球 IC 封装基板行业主要的油墨供应商，如果未来国际贸易摩擦程度加剧，则发行人可能面临原材料油墨进口受限的风险。

¹ 含其在中国大陆等非其本土投资的工厂：例如韩国 IC 封装基板的产值不仅包含其本土工厂产值，也包含其在全球范围内非其本土投资控股的工厂产值，即韩国厂商（资金类别）在全球范围内投资控股的 IC 封装基板厂商。

（三）其他风险

1、发行失败的风险

发行人本次发行能否顺利通过交易所审核并取得中国证监会同意注册的決定，以及取得同意注册批复的时间均存在不确定性。本次发行结果会受到发行时宏观经济环境、相关行业市场情况、投资者对发行人未来发展的评价等多种因素的影响；若本次发行未能足额认购，则存在发行中止甚至发行失败的风险。

2、净资产收益率及每股收益被摊薄的风险

本次发行完成后，发行人的净资产规模及股本总额将在短期内大幅增长。由于募集资金投资项目存在一定建设周期，且从投产到产生效益需要一定时间，因此，本次发行完成后，如果发行人的盈利增幅不达预期，则净资产规模及股本总额的扩大将导致发行人的净资产收益率和每股收益出现一定幅度的下降。

第二节 本次证券发行基本情况

一、本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	本次拟发行不超过5,915.50万股，不低于本次发行完成后股份总数的25%。本次发行不涉及发行人原股东公开发售股份的情形。
每股面值	人民币1.00元
拟上市的交易所和板块	上海证券交易所科创板
发行后总股本	不超过23,662.00万股
保荐机构（主承销商）	开源证券股份有限公司

二、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员介绍

（一）本次具体负责推荐的保荐代表人

开源证券为本次发行项目指定的保荐代表人为王泽洋和宋江龙，其保荐业务执业情况如下：

王泽洋先生，开源证券投资银行总部副总经理，保荐代表人，北京理工大学工学硕士，曾就职于国海证券、太平洋证券，10年以上投资银行经验。曾主持或参与了华源控股、兴瑞科技、清溢光电、航宇科技、古鳌科技等IPO项目；鼎汉技术、宝莱特、威华股份等再融资项目，华源控股重大资产重组项目及众多企业的改制重组等项目。王泽洋先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

宋江龙先生，开源证券投资银行总部执行董事，保荐代表人，注册会计师，中南财经政法大学管理学硕士，曾在国海证券、东兴证券从事投行业务。曾参与项目：航宇科技、华源控股等IPO项目；威达集团、艾格生物、万达重工、邦力达等新三板项目。宋江龙先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人

开源证券本次发行项目的项目协办人为王越，其保荐业务执业情况如下：

王越先生，会计学专业，开源证券投资银行总部高级经理，曾就职于毕马威

华振会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）。曾参与佳华科技（688051.SH）、步科股份（688160.SH）、中微半导体（688380.SH）、五方光电（002962.SZ）、玮言服饰等 IPO 项目工作，具备丰富的资本市场经验。王越先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）项目组其他成员

本次发行项目的其他项目组成员：唐汶金、杨颖然、段永琴、王颖轩、冯玥淇、巫秀芳、闫力扬、许凯丹、林彤。

（四）联系方式

联系地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层，联系方式：029-88365835。

三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况

截至本上市保荐书签署日，保荐机构开源证券及其关联方与发行人及其关联方之间的关系及主要业务往来情况如下：

1、根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规的规定，发行人的保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司，将参与本次发行战略配售，并对获配股份设定限售期，具体认购数量、金额等内容在发行前确定并公告。

除上述情况外，开源证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方，不存在持有开源证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

3、开源证券的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，不存在拥有发行人权益、在发行人任职的情况；

4、开源证券的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方，不存在相互提供担保或者融资的情况；

5、开源证券与发行人之间不存在其他关联关系。

除本次发行外，开源证券及其关联方与发行人及其关联方之间不存在影响本次发行的其他利害关系及其他业务往来。

四、保荐机构内部审核程序和内核意见

（一）关于首次申报的内部审核程序

1、第一阶段：项目的立项审查阶段

业务部门负责人首先对项目组提交的立项申请材料进行审核。质量控制部对立项申请材料进行初审后，安排召开立项会议。立项委员会参会委员在会议上就关注问题向项目组进行询问，并提出专业意见和建议。参会立项委员三分之二及以上同意的项目为立项通过。

2、第二阶段：项目的管理和质量控制阶段

保荐代表人对尽职调查的情况及工作底稿进行全面复核，确保项目的所有重大问题已及时发现并得以妥善解决。质量控制部对项目材料进行审核并安排现场核查，并将初审意见反馈给项目组。项目组应落实初审意见，修改报送材料相关文件，并将落实情况反馈给质量控制部。质量控制部原则上应在收到项目组修改的相关材料后的2个工作日内完成补充审核工作。

业务部门申请启动内核会议审议程序前，应当完成对现场尽职调查阶段工作底稿的获取和归集，并提交质量控制部验收。验收通过的，质量控制部应当制作项目质量控制报告，列示项目存疑或需关注的问题提请内核会议讨论。验收未通过的，不得启动内核会议审议程序。

3、第三阶段：项目的内核审查阶段

内核管理部对申报材料按照开源证券内核工作相关要求就文件的齐备性、完整性和有效性进行核对，申报材料应按证券监管部门相关信息披露规定制作，并保证完整性和齐备性。

内核管理部根据项目类别对应问核文件，组织对问核对象进行问核，并就问核情况发表意见，完成问核后，签字保荐代表人应在问核文件上签字确认，签字确认的问核文件是申请召开内核会的必备要件之一。

内核审议应当在对项目文件和材料进行仔细研判的基础上，结合项目质量控制报告，重点关注审议是否符合法律法规、规范性文件等的相关要求，尽职调查是否勤勉尽责。发现审议项目存在问题和风险的，应提出书面反馈意见。

内核管理部应当对意见的答复、落实情况进行审核，确保内核意见在项目材料和文件对外提交、报送、出具或披露前得到落实。

（二）保荐机构内核意见

开源证券于 2023 年 11 月 22 日召开内核会议对深圳和美精艺半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目申请文件进行审议。本次应参加内核会议的内核委员人数为 7 人，实际参加人数为 7 人，达到规定人数。

经审议，本次内核会议 7 票同意表决通过，会议认为：和美精艺符合首次公开发行股票并在科创板上市的条件，其证券申请文件真实、准确、完整，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等规定，不存在重大的法律和政策障碍，同意推荐深圳和美精艺半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市。

第三节 保荐机构承诺事项

保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，做出如下承诺：

一、保荐机构已按照法律法规和中国证监会及上交所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎调查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序，同意推荐发行人证券发行上市，具备相应的保荐工作底稿支持，并据此出具本上市保荐书；

二、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、上交所有关证券发行并上市的相关规定；

三、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

四、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

五、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

六、保证保荐代表人及其他项目组成员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

七、保证上市保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

八、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

九、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；自愿接受上海证券交易所的自律监管；

十、中国证监会和上交所规定的其他事项。

第四节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见

一、发行人关于本次证券发行的决策程序

2023年10月24日，发行人召开第一届董事会第16次会议，会议审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案》及其他相关议案。

2023年11月10日，发行人召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案》及其他相关议案。

依据《公司法》《证券法》及《注册管理办法》等法律法规及发行人《公司章程》的规定，发行人申请在境内首次公开发行股票并在科创板上市已履行了完备的内部决策程序，决策程序合法有效。

二、发行人符合《证券法》规定的发行条件

经保荐机构逐项核查，发行人符合《证券法》规定的公司公开发行新股的条件：

（一）发行人具备健全且运行良好的组织机构

发行人严格按照《公司法》《证券法》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求设立了股东大会、董事会、监事会以及开展日常经营业务所需的其他必要内部机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员，并依法建立健全了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书等制度。

发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第（一）项的规定。

（二）发行人具有持续经营能力

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2023〕3-451号《审计报告》，报告期内，发行人营业收入分别为18,901.07万元、25,369.54万元、31,199.87万元以及16,228.72万元，归属于母公司所有者的净利润分别为3,687.13

万元、1,924.70 万元、2,932.36 万元以及 1,520.97 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为 3,364.32 万元、1,843.16 万元、2,077.04 万元以及 1,194.37 万元。

发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第（二）项的规定。

（三）发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人最近三年的财务会计报告出具标准无保留意见的天健审〔2023〕3-451 号《审计报告》，发行人符合《证券法》第十二条第（三）项的规定。

（四）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪

发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，发行人符合《证券法》第十二条第（四）项的规定。

（五）发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件

发行人符合经国务院批准的证券监督管理机构规定其他条件，发行人符合《证券法》第十二条第（五）项的规定。

三、发行人符合科创板定位的说明及保荐机构的核查情况

（一）发行人符合科创板行业领域的核查情况

发行人主营业务为 IC 封装基板的研发、生产及销售，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所处行业属于“398 电子元件及电子专用材料制造”之“3982 电子电路制造”；根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，发行人主营产品属于“1.新一代信息技术产业-1.3 电子核心产业-1.3.1 集成电路-集成电路材料-封装材料”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，发行人所处行业为“1.2.1 新型电子元器件及设备制造-3982 电子电路制造-新型连接元件、高密度互连印制电路板、特种印制电路板、柔性多层印制电路板”，属于国家重点支持的战略性新兴产业。

因此，保荐机构认为，发行人属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条第（一）项“新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等”重点推荐领域的企业。

（二）发行人符合科创属性要求的核查情况

序号	科创属性评价标准	是否符合	符合指标情况
1	最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例 $\geq 5\%$ ，或最近三年累计研发投入金额 $\geq 6,000$ 万元	是	最近三年，发行人累计研发投入6,139.70万元，占最近三年累计营业收入比例为8.14%
2	研发人员占当年员工总数的比例 $\geq 10\%$	是	截至2022年12月31日，发行人研发人员数量为70人，占员工总数的比例为13.18%
3	应用于公司主营业务的发明专利 ≥ 5 项	是	截至本上市保荐书签署日，发行人形成主营业务收入的发明专利为16项
4	最近三年营业收入复合增长率 $\geq 20\%$ ，或最近一年营业收入金额 ≥ 3 亿	是	最近一年，发行人营业收入为31,199.87万元，最近三年营业收入复合增长率为28.48%

（三）发行人符合国家产业政策的说明

2017年2月，国家发改委印发的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》中，“封装材料”被列为战略性新兴产业重点产品和服务。2018年11月，国家统计局印发的《战略性新兴产业分类（2018）》，将“新一代信息技术产业”列为战略新兴产业。

2020年9月，国家发改委、科技部、工信部、财政部联合印发《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》将“电子封装材料领域”列为聚焦重点产业投资领域。同年，在国务院发布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》中，明确指出“聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术等的关键核心技术研发，不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制”。

2021年1月，工信部发布《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，指出“重点发展高频高速、高层高密度印制电路板、集成电路封装基板、特种印制电路板”。

2022年10月，国家发改委与商务部发布《鼓励外商投资产业目录（2022年

版)》，将“刚挠印刷电路板及封装基板”列为鼓励外商投资产业。

综上，发行人主营产品 IC 封装基板是半导体芯片封装环节的重要材料，发行人符合国家产业政策支持方向。

(四) 保荐机构关于发行人符合科创板定位要求的核查结论

1、核查程序

针对发行人符合科创板定位，保荐机构执行了以下核查程序：

(1) 查阅发行人工商登记的经营范围；

(2) 查阅国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)、国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》、国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》等产业分类目录、规划或指南的规定，核查发行人所属行业的划分依据；

(3) 查阅分析相关行业研究资料、行业分析报告及行业主管部门制定的行业发展规划等；

(4) 通过公开渠道查询发行人同行业可比公司招股说明书、定期报告等资料，了解其主营业务、主要产品以及行业分类情况；

(5) 将发行人所属行业与《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》中的重点推荐领域进行比对；

(6) 对发行人报告期内的累计研发投入、研发人员数量及划分标准、营业收入及增长情况等进行核查；

(7) 查阅发行人专利证书，获取专利查册证明；核查发行人发明专利数量、发明专利在主营业务中的应用情况；

(8) 将发行人的研发投入、研发人员、发明专利、营业收入等指标与《科创属性评价指引(试行)》相关指标进行逐一比对核实；

(9) 核查发行人出具的《深圳和美精艺半导体科技股份有限公司关于符合科创板定位要求的专项说明》并针对发行人符合科创板定位要求出具专项核查意见。

2、核查结论

经核查，本保荐机构出具了《开源证券股份有限公司关于深圳和美精艺半导体科技股份有限公司符合科创板定位要求的专项意见》，认为发行人符合科创板支持方向、科技创新行业领域和相关指标或情形等科创板定位要求，符合国家产业政策要求。

四、发行人符合《上市规则》规定的上市条件

（一）本次发行申请符合《上市规则》2.1.1 的规定

1、发行人符合中国证监会《注册管理办法》规定的发行条件

（1）本次发行申请符合《注册管理办法》第十条的规定

发行人前身和美有限成立于 2007 年 6 月 28 日，并于 2020 年 12 月 7 日按账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。发行人为依法设立的股份有限公司，且持续经营 3 年以上，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

发行人符合《注册管理办法》第十条的规定。

（2）本次发行申请符合《注册管理办法》第十一条的规定

发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的天健审（2023）3-451 号《审计报告》。

发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证发行人运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的天健审（2023）3-452 号《内部控制鉴证报告》。

发行人符合《注册管理办法》第十一条的规定。

（3）本次发行申请符合《注册管理办法》第十二条的规定

发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：

①发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制

人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易；

②发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷；

③发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

发行人符合《注册管理办法》第十二条的规定。

（4）本次发行申请符合《注册管理办法》第十三条的规定

发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。

报告期内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

发行人董事、监事和高级管理人员不存在报告期内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

发行人符合《注册管理办法》第十三条的规定。

2、发行人股本结构符合在科创板上市要求

本次发行前发行人总股本为 17,746.50 万股，本次拟公开发行不超过 5,915.50 万股人民币普通股，全部为公开发行新股，本次发行完成后发行人总股本不超过 23,662.00 万股。

发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元”规定。

3、拟发行股份比例符合科创板上市要求

经核查，发行人本次拟发行股份不超过 5,915.50 万股，公开发行的股份达到发行人股份总数的 25%以上。

发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上”规定。

（二）本次发行申请符合《上市规则》2.1.2 的规定

发行人本次发行申请适用《上市规则》第 2.1.2 条第（一）项的规定：预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。

1、发行人市值结论

综合发行人报告期内历次股权转让或融资时的估值以及可比上市公司的市净率等情况，发行人预计市值不低于 10 亿元。

2、发行人财务指标

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2023〕3-451 号《审计报告》，发行人 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为 2,932.36 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,077.04 万元，营业收入为 31,199.87 万元，发行人符合“最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”之规定。

综上，发行人市值及财务指标符合《上市规则》2.1.2 之规定。

五、保荐机构推荐结论

保荐机构认真审核了全套申请材料，对发行人进行了全面尽职调查，并与发行人同行业上市公司进行对比分析。在对发行人首次公开发行股票并在科创板上市的可行性、有利条件、风险因素及对发行人未来发展的影响等方面进行了深入分析的基础上，认为发行人符合《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，同

意保荐深圳和美精艺半导体科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市。

第五节 发行人证券上市后持续督导工作的具体安排

主要事项	具体计划
(一) 持续督导事项	证券上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度
1、督导发行人有效执行并完善防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度	(1) 督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度； (2) 与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
2、督导发行人有效执行并完善防止其高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	(1) 督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度； (2) 与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	(1) 督导发行人有效执行《公司章程》《关联交易管理制度》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交易的信息披露制度； (2) 督导发行人及时向保荐机构通报将进行的重大关联交易情况，并对关联交易发表意见
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	(1) 督导发行人严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务； (2) 在发行人发生须进行信息披露的事件后，审阅信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	(1) 督导发行人执行已制定的《募集资金管理制度》等制度，保证募集资金的安全性和专用性； (2) 持续关注发行人募集资金的专户储存、投资项目的实施等承诺事项； (3) 如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构、并督导其履行相关信息披露义务
(二) 保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	(1) 定期或者不定期对发行人进行回访、查阅保荐工作需要的发行人材料； (2) 列席发行人的股东大会、董事会和监事会； (3) 对有关部门关注的发行人相关事项进行核查，必要时可聘请相关证券服务机构配合
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	(1) 发行人已在保荐协议中承诺配合保荐机构履行保荐职责，及时向保荐机构提供与本次保荐事项有关的真实、准确、完整的文件； (2) 接受保荐机构尽职调查和持续督导的义务，并提供有关资料或进行配合
(四) 其他安排	无

(以下无正文)

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于深圳和美精艺半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签章页）

项目协办人：

王越

王越

保荐代表人：

王泽洋

王泽洋

宋江龙

宋江龙

保荐业务部门负责人：

李靖

李靖

内核负责人：

华央平

华央平

保荐业务负责人：

毛剑锋

毛剑锋

保荐机构总经理：

李刚

李刚

保荐机构法定代表人（董事长）：

李刚

李刚



开源证券股份有限公司

2023 年 12 月 21 日